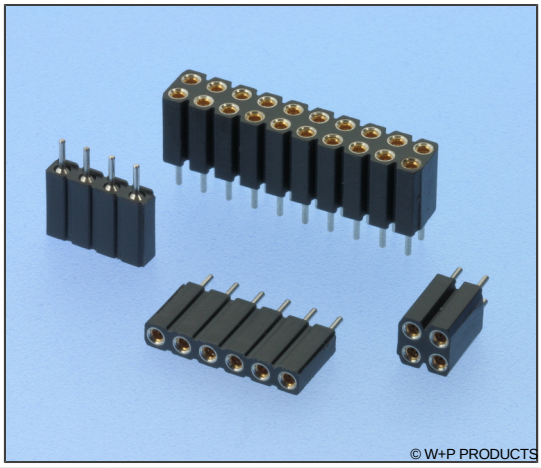
153

Präzisions-Buchsenleisten, RM 2,54mm, gerade, 1-/2-/3-reihig, BH 7mm

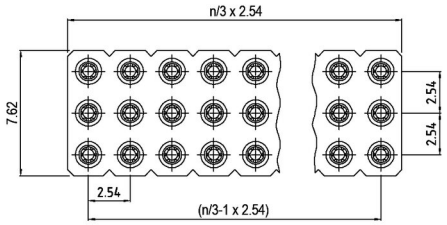
Precision Female Headers, 2.54mm Pitch, Straight, Single/Double/Triple Row, 7.0mm Profile

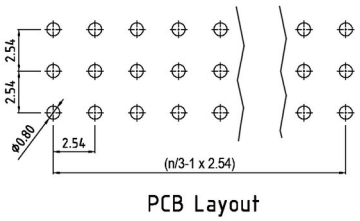
Technische Daten / *Technical Data*

Isolierkörper	Thermoplast, nach UL94 V-0
Insulator	*Thermoplastic, rated UL94 V-0*
Kontaktmaterial	Hülse: Messing gedreht Feder: 6-Finger-Clip für Rundstift Ø0,65-0,85mm oder Vierkantstift 0,635mm, BeCu (andere optional)
Contact Material	*Sleeve: screw machined brass* *Clip: 6-Finger-Clip for round pins Ø0.65-0.85mm or 0.635mm square pins, BeCu (others optional)*
Kontaktoberfläche	Lt. Oberflächenoptionen, über Ni (1,3 ... 2,5µm)
Contact Surface	*Acc. to options (see below), over Ni (1.3 ... 2.5µm)*
RoHS-Ausnahmen 6a-l / 6c	6c; ohne RoHS-Ausnahme mit Option -LF21
RoHS Exemptions 6a-l / 6c	*6c; Option -LF21 w/o RoHS-Exemption*
Durchgangswiderstand	< 10 mΩ
Contact Resistance	*< 10 mΩ*
Isolationswiderstand	> 1000 MΩ
Insulation Resistance	*> 1000 MΩ*
Spannungsfestigkeit	1 kV RMS
Withstanding Voltage	*1 kV RMS*
Nennspannung	100 V RMS / 150 V DC max.
Voltage Rating	*100 V RMS / 150 V DC max.*
Nennstrom	3 A
Current Rating	*3 A*
Temperaturbereich	-55 °C ... +125 °C
Temperature Range	*-55 °C ... +125 °C*
Verarbeitung	Wellen- oder Reflow-Lötverfahren
Processing	*Wave or reflow soldering*

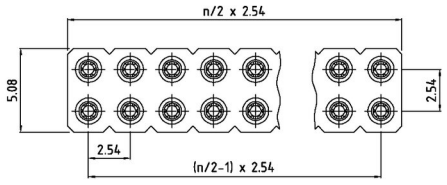


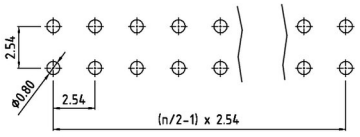
Clip Option	Rundstift *Round Pin*	Vierkantstift *Square Pin*	Fingerzahl *No. Fingers*
[..]	Ø0.65~0.85mm	0.635mm	6
-04-	Ø0.40~0.56mm	0.40x0.25mm	4
-06-	Ø0.40~0.56mm	---	6
-09-	Ø0.95~1.05mm	---	6



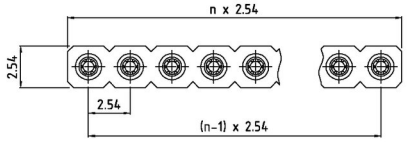


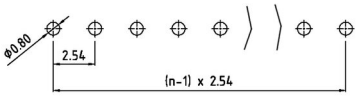
PCB Layout



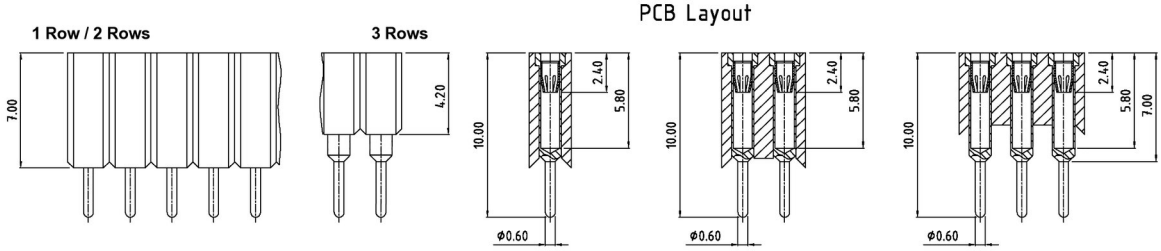


PCB Layout





PCB Layout



Series	*Contacts* *	*Rows* *	*Sleeve Plating*	*Clip Plating* *	*Clip (Optional)* *	*Leadfree (Optional)*
153	**020**	**2**	**50**	**00**	**..**	**LF21**
	002-050 Einreihig *Single row* **004-100** Zweireihig *Double row* **009-096** Dreireihig *Triple row*	**1** Einreihig *Single row* **2** Zweireihig *Double row* **3** Dreireihig *Triple row*	**50** Hülse verzinnt *Tin plated sleeve*	**00** Vergoldet *Gold plated* **10 (opt.)** 0,25µm Au *0.25µm Au* **30** 0,75µm Au *0.75µm Au* **50** Verzinnt *Tin plated*	**[..]** Standard **04** 4-Finger-Clip **06** 6-Finger-Clip **09** 6-Finger-Clip Aufnahmeform u. Dim. siehe obige Tabelle *Counterpart style and dim. see chart above*	**LF21** Auf Anfrage bleifrei ohne RoHS Ausnahme 6c *On request leadfree without RoHS exemption 6c*

* Dies ist ein **Bestellbeispiel** - bitte durch Ihre Spezifikationen ersetzen.
** This is an **order example** - please replace by your specifications.*

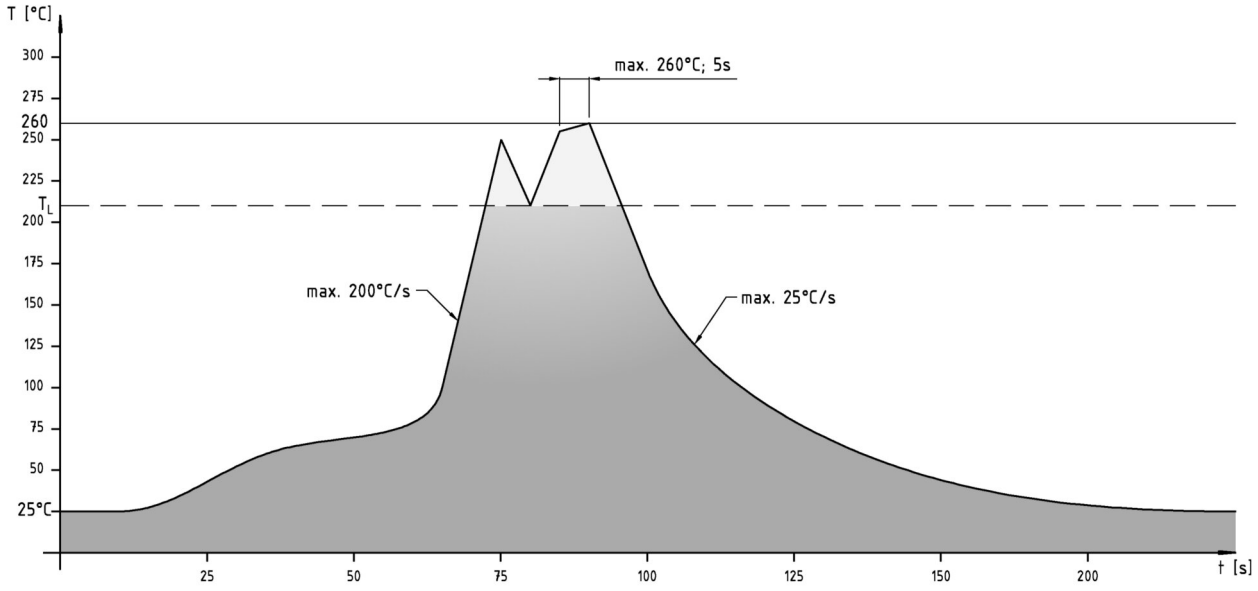
Downloaded from Arrow.com.

Informationen zum Wellen-Lötverfahren
Wave Soldering Information

Empfehlungen für das Wellenlötverfahren

Recommendations for Wave Soldering

Die Bauteile sollten bei einer Lötbadtemperatur von 260°C in max. 5 Sekunden verlötet werden.
Empfohlenes Wellenlötprofil:



Downloaded from Arrow.com.

Reflow-Lötempfehlung für kurze Lötzeiten

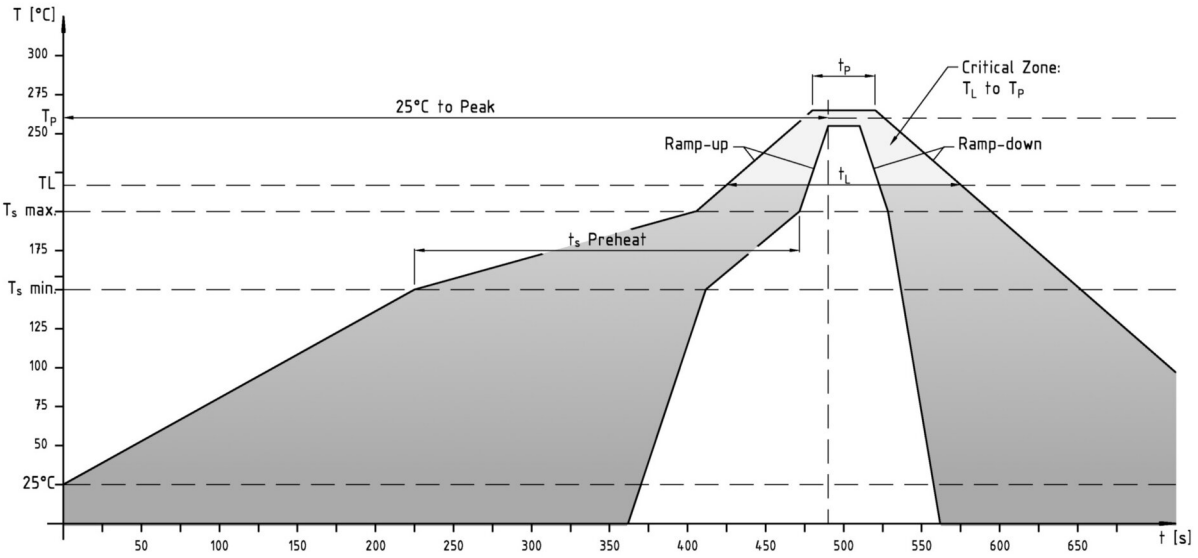
Die Bauteile sollten gemäß folgendem Temperatur-Profil in Anlehnung an die IPC/JEDEC J-STD-020C für bleifreies Löten im Reflow-Verfahren verarbeitet werden (Maximalwerte).

Profileigenschaft	Kennwert
Temperatur Minimum $T_S$min	150 °C
Temperatur Maximum $T_S$max	200 °C
Dauer $T_S$min – $T_S$max	60 – 180s
Temperatur Lötbereich T_L	217 °C
Verweildauer oberhalb T_L	60 – 180s
Ramp-Up Rate $T_S$max – T_P	max. 3 °C / s
Höchsttemperatur T_P	260±5 °C
Dauer Höchsttemperatur	20 – 40s
Ramp-Down Rate $T_P$max – $T_S$min	6 °C / s
Dauer 25 °C – Höchsttemperatur T_P	max. 8m

Reflow Soldering Recommendation For Shorter Peak Times

Items should be soldered according to IPC/JEDEC J-STD-020C temperature profile for leadfree reflow soldering (maximum values).

Profile Feature	Key Values
Minimum Temperature $T_S$min	*150 °C*
Maximum Temperatur $T_S$max	*200 °C*
Duration $T_S$min – $T_S$max	*60 – 180s*
Soldering Range Temperature T_L	*217 °C*
Duration above T_L	*60 – 180s*
Ramp-Up Rate $T_S$max – T_P	*max. 3 °C / s*
Peak Temperature T_P	*260±5 °C*
Duration Peak Temperature	*20 – 40s*
Ramp-Down Rate $T_P$max – $T_S$min	*6 °C / s*
Duration 25°C - Peak Temp. T_P	*max. 8min*



Downloaded from Arrow.com.